

ニュースガイドNo, 11077

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載！

## 無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成27年(1年間) 69点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,600-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,600-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥32,400-	¥30,000-

### 既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,11002	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.26	70点	¥20,000
No,10891	"	"	平.25	70点	¥20,000
No,10830	"	"	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000
No,10201B	"	"	平.19	66点	¥23,100
No,10201A	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997C	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997B	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-平.9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-平.19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-平.17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-平.12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-平.12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-平.12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-平.11	81点	¥31,600

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com))

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
		合計 ¥
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

# 無電解貴金属メッキ方法と工程

No.11077

[公開編] 平成27年(1年間) 69点

CD-ROM版 ¥21,600 B5製本版 ¥21,600 (全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥32,400 )

- |    |                                                |                                      |    |                                                   |                              |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | パラジウムめっき被覆材料、およびパラジウムめっき被覆材料の製造方法              | 東洋鋼鉄株式会社                             | 28 | 無電解めっき方法及び無電解めっき装置                                | 株式会社フジクラ                     |
| 2  | 無電解メッキ液の再生方法                                   | 日本錬水株式会社                             | 29 | めっきの前処理方法および記憶媒体                                  | 東京エレクトロン株式会社                 |
| 3  | 無電解めっき下地転写フィルム、及び当該無電解めっき下地転写フィルムを用いためっき方法     | 出光興産株式会社                             | 30 | めっき組成物を有する構造体、その構造体の製造方法及び無電解めっき方法                | 新光電気工業株式会社                   |
| 4  | パターン化された金属膜が形成されためっき物                          | アキレス株式会社                             | 31 | 無電解めっき方法、無電解めっき装置および記憶媒体                          | 東京エレクトロン株式会社                 |
| 5  | 無電解めっき方法                                       | 三菱電機株式会社                             | 32 | 導電性粒子、導電性粒子の製造方法、導電材料及び接続構造体                      | 積水化学工業株式会社                   |
| 6  | 5員複素環式窒素化合物を含有する無電解メタライゼーション触媒                 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー | 33 | 導電性粒子、導電性粒子の製造方法、導電材料及び接続構造体                      | 積水化学工業株式会社                   |
| 7  | めっき装置                                          | 株式会社荏原製作所                            | 34 | 金めっき用ノンシアン金塩の製造方法                                 | 小島化学薬品株式会社                   |
| 8  | イミノ二酢酸および誘導体を含む無電解金属化のための触媒                    | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー | 35 | 連続白金層の無電解堆積                                       | ラム リサーチ コーポレーション             |
| 9  | 耐熱性部品及びその製造方法                                  | 株式会社フルヤ金属                            | 36 | 無電解めっき液                                           | 三菱瓦斯化学株式会社                   |
| 10 | 有機繊維材料の無電解金属めっき処理方法及び無電解金属めっき繊維                | 名古屋メッキ工業株式会社                         | 37 | 金めっき用ノンシアン金塩の製造方法                                 | 小島化学薬品株式会社                   |
| 11 | 無電解めっき方法                                       | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社           | 38 | 無電解めっき液を用いた貫通電極の形成方法                              | 三菱瓦斯化学株式会社                   |
| 12 | 無電解めっき用触媒、これを用いた金属皮膜及びその製造方法                   | DIC株式会社                              | 39 | 表面に三次元回路が形成された樹脂部品及びその製造方法                        | 日立マクセル株式会社                   |
| 13 | 無電解めっき層の形成方法                                   | 株式会社東亜電化                             | 40 | 無電解めっき方法                                          | 株式会社荏原製作所                    |
| 14 | 無電解めっき下地膜形成用組成物                                | 出光興産株式会社                             | 41 | 積層体及びその製造方法、並びに反射板、ミラーフィルム、抗菌コート、導電膜、熱伝導体         | 富士フィルム株式会社                   |
| 15 | 低温基板上の薄膜を還元する方法                                | エヌシーシー ナノ、エルエルシー                     | 42 | 無電解めっき方法および無電解めっき物                                | 株式会社サーテックカリヤ                 |
| 16 | メッキ膜を有する成形体の製造方法                               | 日立マクセル株式会社                           | 43 | 積層体及びその製造方法、並びに反射板、ミラーフィルム、抗菌コート、導電膜、熱伝導体         | 富士フィルム株式会社                   |
| 17 | 電磁波透過用金属被膜の製造方法及び電磁波透過用金属被膜                    | 三恵技研工業株式会社                           | 44 | 多孔質基材の内部に薄膜化した金属充填層を有する複合体の製造方法および複合体             | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構           |
| 18 | 無電解めっき廃液の処理方法                                  | 国立大学法人信州大学                           | 45 | 金属 - セラミックス回路基板の製造方法                              | DOWAメタルテック株式会社               |
| 19 | 無電解めっき用触媒液                                     | ローム・アンド・ハース電子材料株式会社                  | 46 | 錯体Co <sub>2</sub> +金属イオン還元剤を使用した、連続プラチナ層の無電解堆積    | ラム リサーチ コーポレーション             |
| 20 | 密着性に優れるめっき物及びその製造方法                            | アキレス株式会社                             | 47 | 成形体の製造方法、樹脂ペレットの製造方法、メッキ膜を有する成形体の製造方法、成形体及び樹脂ペレット | 日立マクセル株式会社                   |
| 21 | アルカリに安定なピリミジン誘導体含有触媒による誘電体の無電解メタライゼーション        | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー | 48 | 電解用途用の電極                                          | インドゥストリエ・デ・ノラ・ソチエタ・ペル・アツィオーニ |
| 22 | 無電解めっき用前処理剤、並びに前記無電解めっき用前処理剤を用いたプリント配線基板の前処理方法 | 上村工業株式会社                             | 49 | 有機金錯体                                             | 小島化学薬品株式会社                   |
| 23 | アルカリに安定なピラジン誘導体含有触媒による誘電体の無電解メタライゼーション         | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズ エルエルシー   | 50 | メッキ膜を有する成形体の製造方法                                  | 日立マクセル株式会社                   |
| 24 | 接続端子及びそれを用いた半導体チップ搭載用基板                        | 日立化成株式会社                             | 51 | 金めっき用ノンシアン金塩                                      | 小島化学薬品株式会社                   |
| 25 | 半導体基板、及び、半導体基板の製造方法                            | 富士電機株式会社                             | 52 | 無電解めっき用塗料組成物                                      | 株式会社イオックス                    |
| 26 | 無電解めっき用触媒液                                     | ローム・アンド・ハース電子材料株式会社                  | 53 | パターン化されためっき物の製造方法                                 | アキレス株式会社                     |
| 27 | 無電解めっき方法及び無電解めっき装置                             | 株式会社フジクラ                             | 54 | 無電解めっき下地層形成用組成物                                   | 奥野製薬工業株式会社                   |

以下15点省略